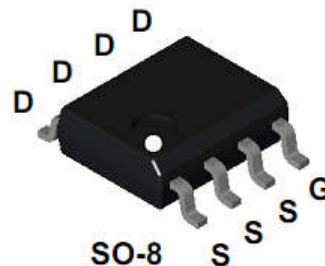


## LYPM9310SP (进口芯片) 型 P 沟道 MOS 场效应晶体管

### 特性

- 参照执行标准：七专筛选 (GS), QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式：S0-8
- 开关速度快，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好
- 替代国外型号：IRF9310PBF



### 极限参数

- 贮存温度  $T_{stg}$ :  $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度  $T_{amb}$ :  $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过  $260^{\circ}\text{C}$ ，焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 $P_D$ (W)	漏源电压 $BV_{DSS}$ (V)	栅源电压 $V_{GS}$ (V)	漏极电流 $I_D$ (A)	导通电阻 $R_{DS}$ ( $m\Omega$ )	热阻 $R_{th(j-A)}$ ( $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ )
LYPM9310SP	2.5 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )	-30	$\pm 20$	-20 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )	4.6	50

### 主要电特性 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=-250\mu\text{A}$	-30	—	—	V
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=-24\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	-1.0	$\mu\text{A}$
		$V_{DS}=-24\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_j=125^{\circ}\text{C}$	—	—	-150	$\mu\text{A}$
正向栅极漏电流	$I_{GSSF}$	$V_{GS}=-20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	-100	nA
反向栅极漏电流	$I_{GSSR}$	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=-100\mu\text{A}$	-1.3	—	-2.4	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=-10\text{V}, I_D=-20\text{A}$	—	—	4.6	$m\Omega$
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=-4.5\text{V}, I_D=-16\text{A}$	—	—	6.8	$m\Omega$
跨导	$g_{FS}$	$V_{DS}=-10\text{V}, I_D=-16\text{A}$	39	—	—	S
电容	$C_{ISS}$	$V_{DS}=-15\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	5250	—	pF
	$C_{OSS}$	$V_{DS}=-15\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	1300	—	pF

SO-8 封装尺寸图:

